

上周英伟达 CEO 黄仁勋正式宣布公司进军 PC 处理器市场，发布面向 Windows 平台的 RTX Spark 系统级芯片，推动 AI 能力从云端数据中心向个人终端下沉。市场普遍看好 AIPC 赛道长期成长前景，核心逻辑有三：一是 AIPC 产业进入全新发展周期，端云协同模式加速落地；二是端侧 AI 渗透率持续攀升，硬件升级与应用生态爆发共同驱动行业高景气；三是算力下沉叠加统一生态构建，带动产业链多环节迎来价值重估。目前机构普遍聚焦 AIPC 核心产业链，重点看好 Arm 架构 SoC 芯片、高端高频 PCB、高带宽存储、ODM 整机代工及面板显示等五大核心方向。随着英伟达 N1/N1X 系列芯片持续赋能与微软 AI 生态不断完善，端侧算力升级与整机价值量提升将同步推进，国产供应链将深度受益于订单放量与技术迭代带来的双重红利。

英伟达入局重塑 PC 生态，AIPC 产业链有望迎来价值重估？

6 月 1 日英伟达 GTC 大会上，黄仁勋的主题演讲再次震撼全球计算产业。随着 RTX Spark 超级芯片（内部代号 N1X）正式亮相，这家全球市值最高的 AI 巨头，正式吹响了进军个人电脑核心处理器市场的号角。黄仁勋直言，这将是 "PC 行业 40 年来首次彻底的重新设计与再造"。

英伟达入局 PC 领域绝非简单的横向业务扩张，而是其构建 "端云一体"AI 生态的决定性战略落子。黄仁勋曾将 AI 产业比作 "五层蛋糕"，英伟达已牢牢掌控最核心的芯片层（GPU），并持续向上游基础设施层延伸。此次发布的 N1X 芯片，创新性地集成了 Blackwell 架构 GPU 与 Arm 架构 Grace CPU，本质是将其在数据中心验证成熟的 "GPU 加速计算+统一内存"技术范式，完整下沉至消费级终端市场，核心目标是抢占 "智能体 AI（Agentic AI）"的本地入口。随着 AI 从生成式对话向自主执行任务的智能体演进，市场对低延迟响应、数据隐私保护和本地算力自主可控的需求正呈爆发式增长。值得注意的是，就在本次发布会前两天，微软、英伟达、Arm 已联合发布"PC 的新时代"预告，三方生态协同为 N1/N1X 芯片的商业化落地铺平了道路。

当前机构普遍看好 AIPC 赛道的中长期成长前景，核心逻辑包括三点：一是 AIPC 已进入技术与产品双轮驱动的新周期，端云协同架构加速落地；二是端侧 AI 渗透率持续快速抬升，硬件迭代升级与 AI 应用爆发将共同驱动行业高景气；三是算力下沉与统一生态构建，将带动 PC 产业链多个环节迎来价值重估。



圖一：英偉達 RTX Spark 超級芯片亮相



資料來源：COMPUTEX 2026（台北国际电脑展）

► COMPUTEX 2026：全球 AI 大咖齐聚，AIPC 成主角

6月1日至5日，2026年国际电脑展（COMPUTEX 2026）在台北盛大举行，本届展会以 "AI Together" 为核心主题，吸引了英伟达、AMD、英特尔、高通、Arm 等全球科技巨头参展，规模创历史新高。展会期间，AIPC 成为全场焦点。各大厂商纷纷发布最新的 AIPC 产品与技术，其中最具有震撼力的当属英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋发布的 RTX Spark 超级芯片。黄仁勋在主题演讲中表示："过去四十年里，人们通过点击和打字来操作计算机，而有了 RTX Spark 和 Microsoft Windows，用户只需提出需求，PC 就会自动完成工作。这是四十年来，第一次对 PC 产品线进行全方位、颠覆性的重新设计。"

*端云协同加速落地，AIPC 迎来黄金发展新周期

英伟达联合微软、Arm 正式发布新一代 Arm 架构 PC 平台，终结了高通在 Windows on Arm 生态的独家垄断地位，标志着 AIPC 产业生态从单一厂商主导，正式迈入多强共建的全新发展阶段。RTX Spark 的核心创新在于首次将企业级 Blackwell GPU 深度集成于 PC 处理器中，并通过 NVLink-C2C 技术实现 CPU 与 GPU 的高速互联。同时，128GB 的统一内存架构使得大模型能够在本地流畅运行，为个人 AI 智能体的普及奠定了硬件基础。凭借极致的能效比优势，彻底解决了传统 x86 架构高功耗的行业痛点，完美适配大内存、低功耗的端侧 AI 计算场景。与此同时，微软 Copilot+PC 生态持续完善，驱动本地 AI 推理需求呈爆发式增长，复杂智能体（Agent）任务已可直接在端侧运行，



大幅降低了对云端算力的依赖。业内普遍认为，此次三方生态深度联动将显著提升端侧算力供给能力、优化系统级运行效率，推动 AIPC 从早期概念渗透加速进入规模化落地阶段，成为端云协同产业发展的核心增量来源。

在性能优势上，与传统 x86 平台相比，英伟达 RTX Spark 芯片在多方面具备显著优势：其 1PF 的端侧 AI 算力达到当前主流 x86 AIPC 的 3-4 倍，可流畅运行更大规模的本地大模型；采用 128GB 统一内存架构，解决了传统 PC 中 CPU 与 GPU 内存分离的痛点，大幅提升大模型推理效率；依托英伟达完整 CUDA、TensorRT 等 AI 软件生态，开发者能够将数据中心的 AI 应用无缝迁移至端侧；同时基于 Arm 架构的 CPU 在能效比上拥有天然优势，可在轻薄本形态下实现高性能 AI 计算。不过 x86 阵营并未坐以待毙，英特尔与 AMD 均计划于今年下半年推出新一代 AIPC 处理器，进一步加码端侧 AI 算力，未来 PC 市场将正式形成英伟达- Arm 与英特尔- AMD 两大阵营分庭抗礼的竞争格局。

图二：英伟达 RTX Spark 超级芯片性能



资料来源：COMPUTEX 2026（台北国际电脑展）



*AIPC 市场规模与前景：从概念走向主流，市场空间广阔

AIPC 是内嵌 NPU（神经网络处理单元）算力、支持端侧大模型运行的下一代个人计算机，随着 AI 技术快速迭代与硬件成本持续下探，正加速从概念验证阶段走向规模化普及。多家权威机构一致预测，2026 年将成为 AIPC 大规模普及的关键拐点：Gartner 数据显示，2026 年全球 AIPC 出货量将达 1.43 亿台，市场渗透率从 2025 年的 31.0% 跃升至 54.7%，首次超越传统 PC 成为市场主流；Canalys 数据显示，2024 年全球 AIPC 渗透率仅有 18%，行业仍处在产业化起步周期，预计 2028 年渗透率抬升至 70%，对应产品销量年化复合增速可达 44%，行业增长弹性突出。

AIPC 市场爆发式增长的核心驱动力来自技术突破、需求升级与政策支持的三重共振。端侧 AI 算力实现跨越式提升，以英伟达 RTX Spark 为代表的新一代 AIPC 芯片将端侧算力推至 PF 级别，使本地运行千亿参数大模型成为现实；个人 AI 智能体需求持续爆发，能够自动执行复杂任务的智能体大幅提升工作效率，成为用户换机的核心动力；同时微软、Adobe、Blender 等主流软件厂商纷纷完成旗下应用的 AI 重构，为 AIPC 提供了丰富的落地场景；政策层面，国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确将 2026 年列为 AI 终端普及关键推进期，提出 2027 年新一代智能终端（含 AIPC）普及率达 70% 的目标，为产业发展提供了坚实保障。

当前 AIPC 仍处于“AI 加持”的初级发展阶段，本质是在传统 PC 功能基础上叠加 AI 辅助能力。未来 AIPC 将全面向“AI 原生”方向演进，整个产业的硬件架构与软件生态都将围绕 AI 进行系统性重构：硬件层面，CPU、GPU、NPU 将深度融合形成统一的 AI 计算架构；交互层面，将从传统的点击、打字模式转变为自然语言交互；应用层面，AI 智能体将成为核心应用形态，用户可通过智能体完成绝大多数任务；安全隐私层面，本地 AI 计算将成为主流趋势，从根本上保障用户数据的安全与隐私。

图三：AIPC 为 AI 大模型应用之一

自然语言交互的个人智能体 - 多模态自然语言交互 UI - 基于本地大模型的个人智能体		内嵌个人大模型 - 本地为主，边缘与云为辅的大模型 - 个性化本地知识库
标配本地混合 AI 算力 - CPU&NPU&GPU 本地混合计算架构 - 个人终端和家庭主机 / 企业边缘主机协同计算	开放的 AI 应用生态 - AI 原生应用、AI 赋能应用 - 能够被智能体任务调度、适配混合 AI 算力平台等	设备级个人数据 & 隐私安全保护 - 本地隐私推理 & 非敏感任务调用云端大模型 - 硬件级安全芯片保护 & 个人数据加密 / 脱敏传输

资料来源：AI PC 产业白皮书



► 投資者應該關注行業內哪些投資機會？

AIPC 正迎來黃金發展新周期，其中端側算力升級驅動的硬件替換潮是当前確定性最強的第一增長曲線。全球主流 PC 廠商加速 AIPC 產品布局，截至 2026 年 Q1 已發布的 AIPC 機型超 200 款，Gartner 預測 2026 年全球 AIPC 出貨量將達 1.43 億台，滲透率從 2025 年的 31.0% 躍升至 54.7%，首次超越傳統 PC 成為市場主流。端側 AI 算力的跨越式提升是行業爆發的核心驅動力，以英偉達 RTX Spark 為代表的新一代 AIPC 芯片將端側 AI 算力推至 1PF 級別，較上一代產品提升 10 倍以上，使本地運行千億參數大模型成為可能；同時 AIPC 平均售價從 2024 年的 1200 美元降至 2026 年的 800 美元左右，成本下探為大規模普及掃清了障礙。另一方面，端雲協同的智能體經濟作為 AIPC 技術的核心應用延伸，正迎來技術與需求的双重紅利，隨著微軟、英偉達、Arm 聯合發布 PC 智能體標準，個人數字助理、企業智能辦公、工業智能运维等場景將加速落地，預計未來 5-10 年中國端側智能體經濟市場規模將快速增長。

投資機會方面，建議重點關注 AIPC 產業鏈核心環節的龍頭標的：整機 ODM 環節，龍頭華勤技術 (603296.SH) 已率先完成英偉達、英特爾、AMD、高通四大主流平台全覆蓋，适配能力行業領先，其深度綁定聯想、戴爾、惠普等全球頭部 PC 廠商；上游芯片端，國內 MCU 龍頭兆易創新 (3986.HK) 前瞻布局端側 NPU 芯片，有望受益於端側 AI 算力需求爆發；顯示與交互環節，全球前二面板龍頭京東方 A (000725.SZ)、TCL 科技 (000100.SZ) 將充分享受 AIPC 顯示升級帶來的增量需求；結構件環節，全球消費電子結構件龍頭藍思科技 (6613.HK) 是 AIPC 玻璃及金屬結構件的核心供應商；整機品牌端，與英偉達深度合作的聯想集團 (0992.HK) 是 AIPC 轉型的核心受益方。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

